真空镀膜 实验报告

蔡丹杨

(北京大学化学与分子工程学院 1700011774)

1 数据处理

实验使用的装置如图 1 所示(引用自教材)。为使镀膜能较为成功,按照公式 $\lambda=\frac{kT}{\sqrt{2\pi}d^2p_{\max}}$,代入以下数据: $T\approx 300$ K, $d_{Cu}\approx 3.7$ Å, $\lambda=5L\gg L\approx 0.10$ m后,算得 $p_{\max}\approx 13.6$ mPa。

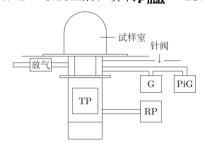


图 1 实验装置

RP. 机械泵(Rotary vane pump); TP. 分子泵(Turbomolecular pump); PiG. 冷规(Penning ionization gauge); G. 热偶规(Pirani gauge)

(1) 抽真空阶段

分子泵有较大转速后,从给定时间零点开始,记录气压计示数,并作p-t关系图,结果如图 2 所示。

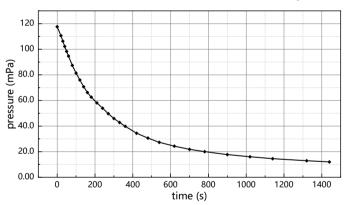


图 2 抽气阶段的压强一时间关系曲线

(2) 预蒸发阶段

当气压计示数变为 11.7mPa 时,加上 5A 预蒸发电流,记录并作p-t关系图,结果如图 3 所示。

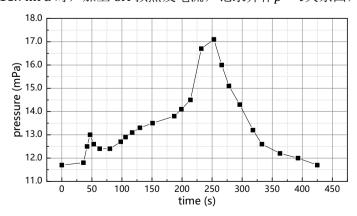


图 3 预蒸发阶段的压强—时间关系曲线

(3) 蒸发镀膜、第二次抽真空

在压强示数恢复后,缓慢加电至 30A, 至观察窗镀上铜后断电、放气、冷却。记录得**此过程中装置内最大压强为 162.3mPa**。随后重复做了一次实验,抽真空阶段的几组压强—时间记录如表 1 所示。从中可以看到,第二次抽真空速率显著快于第一次,达到同样压强所需时间大约只有第一次的 70%。

p/mPa	117.6	102.2	66.2	30.6	12.9
<i>t</i> ₁ /s	0	40	160	480	1320
<i>t</i> ₂ /s	0	22	101	342	935

表 1 第一次(t)与第二次(t)抽真空达到相同真空度用时比较

2 分析与讨论

(1) 真空度下限的确定

为了能按单次碰撞过程处理,要求 $\lambda \gg L$,取 $\gg := \geq 5$ 。按公式 $\lambda = kT/\sqrt{2}\pi d^2 p_{\text{max}}$,需要代入的常数有 T,d,p_{max} 。其中,按老师给出的数据d=3.7Å, p_{max} 为待求/测数据,重点是T的选取。

老师认为,由于真空的导热性能较差(自由程极长),装置只有通电部分为高温区域,大部分空间的温度都接近于室温 300K,所以 T 也应取此值。但实际上,通电结束后若放气并取下钟罩,会发现整个内筒都很烫,而外部温度确实接近于室温。因此我认为,内筒和外筒的压强相差较大,计算自由程时应考虑到内筒充满了不断凝华放热的铜蒸汽。具体来说:

取镀膜过程中达到的最大压强 162.3mPa,代入 Cu 固体的蒸汽压公式¹,算得该条件下饱和铜蒸汽的沸点是 1036K。代入上述公式,得自由程为 $\lambda = \frac{1.3807 \times 10^{-23} \times 1036}{1.4142 \times 3.1416 \times (3.7 \times 10^{-10})^2 \times 0.1623}$ m \approx **0**. **14m** \approx *L*,可见虽然不满足远大于的条件,但仍可近似为单次碰撞过程。

(2) 抽真空阶段

对于本阶段,有可能抽象出以下模型²: 由于分子泵的构造,其抽气速率与剩余气体量成正比; 而钟罩等处漏气量始终与内外压强差成正比; 两者最终达到平衡。记比例系数为 α 和 β ,则微分方程及解为:

$$\begin{cases} \frac{dP}{dt} = -\alpha P + \beta (P_0 - P) = -(\alpha + \beta)P + \beta P_0 \\ P(t) = \frac{\beta P_0}{\alpha + \beta} (1 - e^{-(\alpha + \beta)t}) + e^{-(\alpha + \beta)t} P(0) \\ P(\Delta t) \sim P(0) - [(\alpha + \beta)P(0) - \beta P_0] \Delta t \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(0) = 117.7 \text{mPa} \\ (\alpha + \beta)P(0) - \beta P_0 = 0.3824 \text{Pa/s} \\ r = 0.99958 \end{cases}$$

由左边最后一式,可取最初几个数据点作线性拟合,以求出待定比例系数。取了前 7 个数据点 (计算过程略),结果如右边方程组所示。又因为 $t\to\infty$ 时 $P(t)\to\beta P_0/(\alpha+\beta)$,代入 $\beta P_0/(\alpha+\beta)=11.6$ mPa,最终定出两个比例系数,并作出拟合曲线,如图 4 所示。

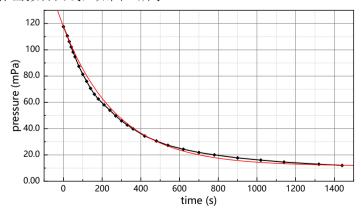


图 4 拟合的抽气阶段的压强一时间关系曲线

¹ CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th ed.; Lide, D.R., Ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2017; pp 839.

² http://laserroger.github.io/LaserPublic

拟合结果相对来说仍有不足,原因是抽气过程最开始时,钟罩内各处压强不是完全相同的,不能应用模型中的近平衡态假设;另外,最初分子泵的转速还未稳定为704r/s,也是可能的偏离原因。

(3) 预蒸发阶段

该阶段采用 5A 电流,基本不足以蒸发 Cu,但能去除大部分低熔点杂质。

过程中,**压强先增加后下降**,这是因为杂质先是被升温的钼丝蒸出,随着杂质基本蒸干,蒸发量越来越少。最后压强恢复到和未加电流前一样,进一步说明 Cu 基本不会被蒸发。**电流先是剧烈波动,当压强开始下降后则渐渐稳定**,说明铜丝中的低沸点杂质蒸发导致了铜丝的总电阻变化,造成电流不稳定,后来杂质数量减少,对电阻的影响减弱,从而蒸发电流逐渐稳定。由于未接质谱等分析装置,不能确定杂质成分。

\bigcirc

(3) 蒸发镀膜阶段

关于镀膜效果的讨论可见前面"真空度下限的确定"小节。为了使镀膜密实,一方面是确保盖玻片充分接触铜蒸汽后再断电;另一方面,需要仔细处理待镀表面,避免沾染油污、灰尘、水汽。否则,都会使得镀层对表面附着力低,疏松易剥落。

关于**为什么选择 Cu 而非熔点更低的 Al 作为镀膜材料**,主要是考虑到 Al 在镀膜过程中的高度活性,包括以下几点: 1.Al 原子半径小,与电阻丝在高温下可能形成合金而减少蒸发; 2.Al 在空气中立即形成致密氧化膜,即使多次打磨也需要长时间预蒸发才能除去表面杂质; 3.Al 活性太强,通电加热后可能与残余氧气发生剧烈燃烧,或与其他金属部件发生还原反应。



观察到,随着电压加大,内筒窗口上透出类似白炽灯的光,随后内部出现类似蓝色蒸汽,最后窗口逐渐变黑。这分别说明了:被加热物体的发射极大值向短波方向移动;铜对蓝色吸收率低而反射紫红色多;窗口上附着了一层铜镀膜。

(4) 第二次抽真空

对比数据可见,两次抽真空达到相同真空度所用的时间确实有明显差异。推测**这是由于分子泵首次使** 用时,排出了器壁表面吸附的气体分子等杂质,导致抽真空效率提高而产生的。

(5) 其他

正如老师所说,不选用同样熔点高而电阻大的钨丝的原因是钨丝的柔韧性较差,加工时容易直接开裂分叉,造成加热器不合格。

镀膜完成后取下钼丝,发现缠绕的螺旋状钼丝在缠绕点处断裂。初步分析,可能是在缠绕中为调整钼丝 角度,扭转钼丝一次以上,导致弯折处的钼丝变得脆弱,电阻率和发热功率增大,因而在通电加热过程中被 烧断。由此可见,钼丝的处理一定要干脆利落,最好一步到位,定型后不要再弯折,否则容易烧断。

3 收获与感想

通过本次实验,我了解了真空技术的有关知识,进一步提高了操作能力,为以后的实验打下了基础。 感谢刘老师对实验过程的指导,以及王世伟同学对操作仪器的帮助。